

苏州德龙激光股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：投2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	全体通过网络互动方式参与德龙激光2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的投资者
时间	2026年5月20日
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：赵裕兴 董事、副总经理、董事会秘书：袁凌 财务总监：李苏玉 独立董事：朱巧明

## 投资者关系活动主要内容

## 一、 问答环节

**（一）董秘，你好，请介绍一下公司 2025 年度、2026 年第一季度营收相关情况？**

答：尊敬的投资者您好！公司 2025 年度实现营业收入 7.87 亿元，较上年同期增加 10.10%，2025 年全年实现归属于上市公司股东的净利润 2584.79 万元，实现扭亏为盈，主要原因：

- 1、2025 年公司产品验收增加，推动本期营业收入增长。同时公司积极践行提质增效行动，加强费用管控，2025 年销售费用、管理费用和研发费用控制良好，使得财务表现改善；
- 2、2024 年，因参股公司股权存在减值迹象，基于谨慎性原则，对参股公司计提长期股权投资减值损失；2025 年无此因素影响；同时 2025 年公司回款良好，相应计提的信用减值损失减少；
- 3、2024 年，根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的相关规定，公司对递延所得税资产和递延所得税负债进行了复核。基于谨慎性原则，对以前年度母公司确认的递延所得税资产和递延所得税负债予以冲回，净额为 2,447.49 万元，减少了 2024 年净利润，2025 年无此因

素影响。

2026年第一季度实现营业收入0.87亿元，较去年同期下降11.93%，第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-2553.14万元，比去年同期利润减少906.10万元，主要原因是：

- 1、公司一季度新签订单增长较快，为保障交付质量，公司当期资源向订单交付环节侧重，一季度营业收入出现阶段性波动，本期营业收入比上年同期下滑11.93%；
- 2、销售费用比上年同期增加271.31万元，主要是为支持销售订单，销售相关的人员和费用有一定增加；
- 3、管理费用比上年同期增加295.91万元，主要是江苏德龙一期土建工程上年末竣工，折旧和摊销费用比上年同期增加。

感谢您对德龙激光的关注！

## **(二) 尊敬的赵总，你好，请问公司在存储芯片方面，有哪些技术与设备的应用？**

答：尊敬的投资者您好！近年来，公司积极布局高端芯片领域，存储类超薄芯片对性能、稳定性、可靠性及切割效果要求较高，针对存储芯片方向开发了晶圆激光隐切设备（SDBG）、晶圆激光开槽设备、激光打标设备等产品，其中晶圆激光隐切设备（SDBG）已取得小批量订单，其它产品正在验证阶段，感谢您对德龙激光的关注！

## **(三) 公司激光精密加工设备在半导体领域的国产替代进展如何？**

答：尊敬的投资者您好！公司专注于激光精细微加工技术产品开发，助力国家高端制造业的发展，始终坚守技术自主创新发展路径，以前沿技术引领产业升级，全力推进相关领域产品国产化替代进程。成立20多年以来公司陆续推出了多款进口替代产品，如面向第三代半导体的碳化硅晶圆切割设备、针对Micro LED领域开发的Micro LED 巨量转移设备，2025年公司推出了硅晶圆激光隐切设备（SDBG）进入存储芯片领域，该设备通过光学整形技术，球差矫正算法，高精度高速度平台，高品质激光系统实现晶圆内部高品质隐形切割能力，实现进口替代。感谢您对德龙激光的关注！

## **(四) 赵董事长好！首先恭喜公司在高端激光设备领域取得一系列的突破。请教董事长两个问题：1、预计2026年公司相关激光设备出货量增长主要会在存储芯片领域、光模块领域、PCB领域还是固态电池领域？2、目前公司针对长江存储的出货情况如**

何？是否已经形成批量订单？另外公司是否已经通过长鑫存储的测试认证？谢谢！

答：尊敬的投资者您好！公司专注于激光精细微加工领域，聚焦于半导体、电子、锂电、光伏和面板显示等应用领域，公司设备属于专用激光设备，专用设备领域呈现产品体系丰富多样，但受细分应用场景制约，出货量整体偏小的特点。在存储芯片领域，公司开发了晶圆激光隐切设备（SDBG）、晶圆激光开槽设备、激光打标设备等产品；在光模块领域，公司主要为行业知名客户提供自动化装配及自动化检测解决方案，以及激光蚀刻、切割、焊接和键合等解决方案；在PCB领域，公司开发了包括应用于PCB硬板、FPC软板、软硬结合板等线路板材料的切割、打标、钻孔等成熟的激光精细微加工产品矩阵；在固态电池领域，公司推出了极片制痕绝缘方案，同时正在验证激光加热、超快激光制片等新工艺。上述产品在公司整体收入中占比较小，请注意投资风险。公司与客户的业务具体合作信息涉及相关商业保密条款，在此不便透露，敬请谅解。公司的主要业务进展情况请详见公司在上交所披露的相关定期报告。感谢您对德龙激光的关注！

附件清单（如有）

无

日期

2025年5月21日